

課題番号 : F12WS-0049
支援課題名 (日本語) : シリコン製基板と樹脂との接合メカニズムに関する研究
Program Title (in English) : Studies on bonding mechanism of pretreated polymer to Si-wafer.
利用者名 (日本語) : 青木 孝綱
Username (in English) : Takatsuna Aoki
所属名 (日本語) : キヤノン インクジェット技術 2 1 開発室
Affiliation (in English) : Inkjet Technology Development Dept.21 CANON

概要 (Summary) :

シリコン-樹脂間の接合に必要な製法パラメータと接合強度の関係を明確化し、長期信頼性のある新規デバイス開発への応用展開を図ることを期待する。
そのために、ズースマイクロテック社製 SB6E の使用を検討する。

実験 (Experimental) :

なし。

結果と考察 (Results and Discussion) :

なし。

その他・特記事項 (Others) :

なし。

共同研究者等 (Coauthor) :

なし。

論文・学会発表

(Publication/Presentation) :

なし。

関連特許 (Patent) :

なし。